

TECHVIMAT

**LICENCE
PROFESSIONNELLE**

**TECHNOLOGIES
DU VIDE ET DES
MATÉRIAUX**

DEVENEZ CADRE TECHNIQUE EN TECHNOLOGIES DU VIDE

Les points forts de la formation

100%
D'INSERTION
PRO

- ▶ Une formation unique en France ;
- ▶ Des domaines en pleine expansion : nucléaire, aéronautique, matériel médical ;
- ▶ Industrie de haute précision : horlogerie, défense, lunetterie ;
- ▶ De nombreuses offres d'emplois au niveau national ;
- ▶ Une formation en alternance, rémunérée ;
- ▶ 100% d'insertion pro 6 mois après la fin de la formation.



J'ai

Le goût des matières scientifiques et techniques ;

Un intérêt pour les secteurs d'activités et les technologies de pointe (spatial, microélectronique, accélérateur de particules, optique infrarouge, mécanique...);

Un DUT, BTS, L2 dans les secteurs de la mesure (Mesures Physiques), des matériaux, de la physique, de la chimie, de la mécanique, de l'optique, de la productique, de l'électrotechnique, du thermique, de l'énergie et de la maintenance.

Me forme dans les domaines des technologies du vide ;

Maîtrise les installations de dépôts de couches minces (dépôts de matériaux d'épaisseur de l'ordre du nanomètre, micromètre) ;

Développe des technologies capables de donner aux objets des caractéristiques particulières et innovantes (antireflet, conversion d'énergie, résistance à l'usure, semi-conducteur...);

Suis capable de caractériser et de réaliser des mesures sur les matériaux déposés ;

Fais preuve de polyvalence

Avec la LP TECHVIMAT, je

TECHVIMAT

DÉPARTEMENT MP



Débouchés & Métiers

Les entreprises ► **AIR LIQUIDE, ALLIANCE CONCEPT, CEA, CILAS, ESSILOR, HEF, PFEIFFER VACUUM, SAFRAN, SOFRADIR, SOITEC, THALES, Thermi Lyon...**

Les métiers ► **Assistant ingénieur ultravide, Technicien dépôts couches minces, Contrôleur salle blanche, Technicien maintenance vide, Ingénieur des ventes...**



Exemples de missions d'alternance

Marie-Clotilde	IREIS/HEF	J'ai participé à des projets de recherche et développement en effectuant des dépôts de couches minces sous vide.
Renaud	THALÈS	Ma mission consiste à mettre en place des mesures de vide primaire à l'intérieur d'un satellite.
Emmanuel	AIR LIQUIDE (CERN)	J'effectue des tests de recherche de fuites sur composants liés aux accélérateurs du CERN.
Margaux	ESSILOR	J'ai contribué à l'amélioration des caractéristiques de couches antireflets sur des verres de lunettes.



Programme

Grands Domaines	Quelques Matières
FORMATION SCIENTIFIQUE	Plasmas, matériaux, physique, mathématiques
COMMUNICATION, ENTREPRISE	Anglais, expression-communication, droit du travail...
TECHNOLOGIE DU VIDE	Réalisation de dépôts sous vide, technologie de pompage, contrôle et mesures sous vide...
TRAITEMENTS DE SURFACES	Caractérisation de dépôts sous vide, procédés industriels, méthodes de caractérisation...
SI PARCOURS SURFACES	Etudes de cas (caractérisation de couches...), physico-chimie des matériaux...
SI PARCOURS CONCEPTION	Conception de matériel de vide, équipement sous vide...

Moyens pédagogiques et/ou techniques innovants :

- Plateforme technologique interne à l'IUT (matériaux et dépôts de couches minces)
- Équipement technique de pointe
- TOEIC compris dans la formation

RENSEIGNEMENTS, CANDIDATURES, INSCRIPTIONS

Département MP ; iutmph@univ-st-etienne.fr ; 04.77.46.34.51

Service Formations et Entreprises ; iutse-formation@univ-st-etienne.fr ; 04.77.46.33.21

28, avenue Léon Jouhaux CS 92320 42023 Saint-Etienne

www.iut.univ-st-etienne.fr



LP TECHVIMAT

Comment postuler :

Candidature via www.iut.univ-st-etienne.fr
Pré-sélection sur dossier, puis entretien d'admissibilité

Validation du diplôme :

Contrôle continu (IUT et entreprise) et rapport d'alternance + soutenance

Équipe pédagogique :

Enseignants de l'IUT et intervenants professionnels **(55% d'intervenants pro)**

Rythme d'alternance :

5 sessions de 3 semaines à l'IUT

Comment bénéficier de la formation :

- Contrat de professionnalisation
- Congé de formation, période de professionnalisation (salariés)
- Demandeurs d'emploi (convention ou contrat de professionnalisation)
- Possibilité de Validation des Acquis de l'Expérience

